

2023年8月1日

# NEWS RELEASE

これまで、これからも。

Safety &  
Value

 **TMES株式会社**

東京都港区芝浦 4-13-23

## 第7回 スマートビルディング EXPO【大阪】 出展のお知らせ

スマートビルディング EXPO は、毎年大阪・東京にて、先端技術に特化した建築総合展内で、盛大に開催されております。開催を今月下旬に控えた 2023 年の大阪展に、当社は昨年に引き続き出展いたします。詳細は下記の通りになりますので、どうぞご期待ください。

また、12月の東京展にも出展を予定しておりますので、出展内容等が決まりましたら、改めてご案内いたします。

ぜひ、皆様のご来場をお待ちしております。

### 記

#### 1. 展示会概要

展示会名	第7回 【大阪展】スマートビルディング EXPO (あらゆる建築物を対象とした建築総合展 「JAPAN BUILD OSAKA -建築の先端技術展-」内で開催)
概要	「BEMS」「ビル向けIoT」など、次世代ビル設計・工事・管理に必要なあらゆる技術が一堂に出展される展示会
URL	<a href="https://www.japan-build.jp/osaka/ja-jp/visit/sbd.html">https://www.japan-build.jp/osaka/ja-jp/visit/sbd.html</a>
開催期間	2023年8月30日(水)～2023年9月1日(金)
会場	インテックス大阪(6号館)【Cゾーン(3F)】

#### 2. 出展概要

概要	当社のブースでは、『省力化』『省人化』『省エネ化』をキーワードにした様々な製品及びサービスを展示しております。また、ブース内でのセミナー開催を予定しております。以下の URL をクリックいただくと、出展情報の閲覧や商品パンフレットのダウンロードが可能です。
URL	<a href="https://www.japan-build.jp/osaka/ja-jp/search/2023/directory/details.tmes%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89.org-b6322374-e40e-4590-9ee4-59849b9b8cb5.html#/">https://www.japan-build.jp/osaka/ja-jp/search/2023/directory/details.tmes%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89.org-b6322374-e40e-4590-9ee4-59849b9b8cb5.html#/</a>
ブースナンバー	11-35

2023年8月1日

# NEWS RELEASE

これまで、これからも。

Safety &  
Value

## 3. セミナーの概要

テーマ	IoTを活用した施設運営維持のスマート化
内容	労働人口減少に加え働き方改革が叫ばれる中、施設運営維持業務においても当然ながら省力化・省人化が求められています。各種センサやIoTカメラを実際に活用しスマート化した事例を紹介します。また、データを活用した予防保全やセンサ・カメラの最新情報を紹介します。
講演日時	2023年8月31日(木) 10:30~11:15
登壇者	①株式会社村田製作所 通信・センサ事業本部 IoT事業推進部 ワイヤレスソリューション商品技術課 シニアマネージャー 島倉 英悟 様 ②LiLz株式会社 代表取締役社長 大西 敬吾 様 ③弊社 執行役員営業本部長 西片 一成
申し込み	講演への参加には、入場事前登録とは別に事前申し込みが必要です。 ぜひ、当社セミナーの聴講にお越しくください。 【申込ページ】 <a href="https://biz.q-pass.jp/f/7391/jb_seminar_kansai_23?fid=eZxJWo2xSw9uq23j">https://biz.q-pass.jp/f/7391/jb_seminar_kansai_23?fid=eZxJWo2xSw9uq23j</a> キーワード：スマート化・ウェルネス セッションコード：SMT-3

本件に関するお問い合わせ先

T M E S株式会社 経営企画部 CSR 推進室 笠原、西口

TEL : 03-6453-6691 E-mail : tmkouhou@tte-net.com